

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併財務報告附註

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

(除另予註明者外，金額為新台幣仟元)

一、公司沿革

台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積公司）設立於 76 年 2 月 21 日。主要從事於有關積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計及光罩製造等代工業務。台積公司股票自 83 年 9 月 5 日起於台灣證券交易所上市。86 年 10 月 8 日起，台積公司部分已發行之股票以美國存託憑證方式於紐約證券交易所上市。台積公司註冊地及業務主要營運據點為新竹科學園區力行 6 路 8 號。台積公司之子公司之主要營運活動，請參閱附註四之說明。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告業已於 111 年 11 月 8 日經本公司董事會核准並通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

- (一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRSs」）

適用金管會認可並發布生效之 IFRSs 不致造成台積公司及其子公司（以下合稱本公司）會計政策之重大變動。

- (二) 112 年適用之國際會計準則理事會（IASB）已發布並經金管會認可之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
國際會計準則第 1 號之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日
國際會計準則第 8 號之修正「會計估計值之定義」	2023 年 1 月 1 日
國際會計準則第 12 號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	2023 年 1 月 1 日

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
國際財務報導準則第 10 號及國際會計準則第 28 號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未 定
國際會計準則第 1 號之修正「負債分類為流動或非流動」	2024 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「具合約條款之非流動負債」	2024 年 1 月 1 日

截至本合併財務報告發布日止，本公司仍持續評估上述準則、解釋之修正及相關適用期間對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

除下列說明外，本合併財務報告所採用之會計政策與 110 年度合併財務報告相同。

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有經金管會認可並發布生效 IFRSs 揭露資訊。

(二) 合併基礎及原則

1. 合併報告編製原則

本合併財務報告所採用之合併報告編製基礎及原則與 110 年度合併財務報告相同。

2. 列入合併財務報告之子公司

本合併財務報告編製主體如下：

投資公司名稱	子 公 司 名 稱	主 要 業 務	設立及營運地點	本公司所持有之所有權權益百分比			說 明
				111年 9月30日	110年 12月31日	110年 9月30日	
台積電公司	TSMC North America	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務	San Jose, California, U.S.A.	100%	100%	100%	—
	TSMC Europe B.V. (TSMC Europe)	客戶服務及支援業務	Amsterdam, the Netherlands	100%	100%	100%	註一
	TSMC Japan Limited (TSMC Japan)	客戶服務及支援業務	Yokohama, Japan	100%	100%	100%	註一

(接次頁)